

MA300

フェイスダウン&アップ LSI 実装システム
Face down&up LSI bonding system

三次元半導体の組立に最適 Optimized assembly system for 3D-LSI



フレキシブルな工法対応 Flexible process

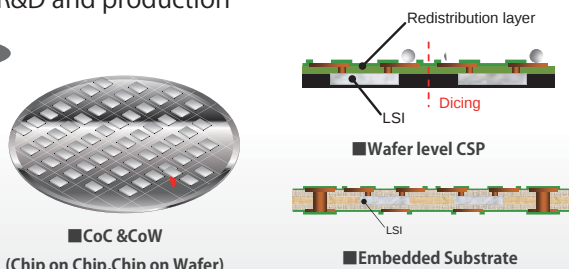
高精度接合制御 Precision bonding control

高精度ダイボンド Precision die attach

アプリケーション Application

三次元半導体などの最新半導体パッケージ技術開発と生産
3D-LSI R&D and production

適用例

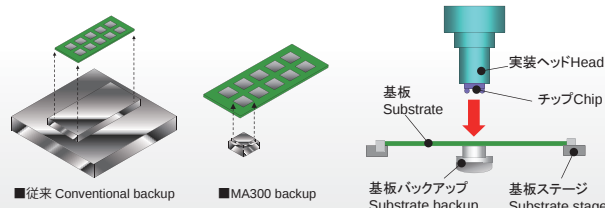


概要 Overview

大型基板対応が容易なダイレベルバックアップコンセプト
Die level back up concept suitable for large size substrate

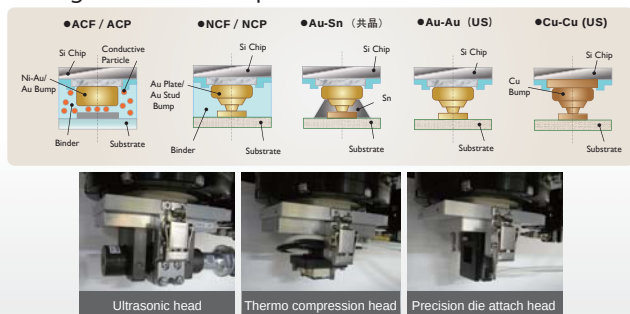
バックアップ小型化
Minimized backup

平面が出しやすい
Easy parallel adjustment



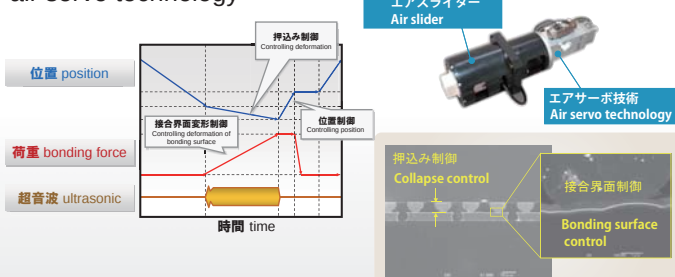
フレキシブルな工法対応 Flexible process

各種工法に合わせて交換可能なプロセスヘッド
Exchangeable head for process variation



高精度接合制御 Precision bonding control

エアサーボ技術による高精度押込み・界面制御
Precision control for collapse and bonding surface with air servo technology

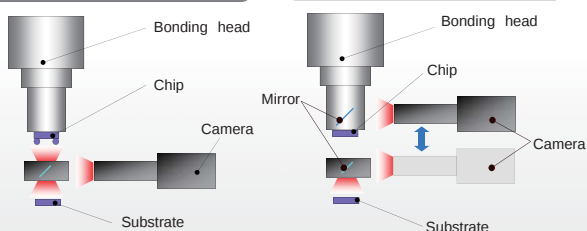


高精度ダイボンド Precision die attach

フリップチップと高精度ダイボンドモードを装備
Flip chip and precision die attach mode in one machine

フリップチップモード
Flip chip bonding mode

ダイボンディングモード
Die attach mode



仕様 Specification

Alignment accuracy	X,Y: $\pm 5 \mu\text{m}$
Bonding force	10 ~ 300N(option: max 100,500,700)
Head availability	Ultrasonic, Thermo compression, precision die attach
Ultrasonic head	50 kHz
Ceramic heater head	Max350℃
Head control	bonding force, ultrasonic digital control
Chip size	$\square 1 \sim 12\text{mm}$, $t50 \sim 725 \mu\text{m}$
Substrate size	Max500x600mm, 300mm wafer
Bonding area	$\square 300\text{mm}$, (300mm wafer : $\square 280\text{mm}$)
Utility	Pressure air 0.49MPa Dry air Vacuum -80 kPa Power 3phase 200V
Machine size	W1 400 x D1 450 x H1 900
Machine weight	1 200kg

開発 / 製造

adwelds
advanced welding & bonding technologies

株式会社アドウェルズ <http://www.adwelds.com>
〒811-1201 福岡県筑紫郡那珂川町片縄 8 丁目 140 番地
TEL 092-555-6000 Mail info@adwelds.com

販売

PMT CORPORATION

株式会社ピーエムティー <http://www.pm-t.com>
〒811-2115 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷 1705-1
TEL 092-933-3110